

Schichten: 2

Material: FR4

Fertige Stärke: 1,57 mm +/- 10%

Kupferschichtdicke der äußeren Schicht: 1 Unze

Finish: ENIG (Au: 2-5u ")

Soldermask (Farbe): Beide Seiten, LPI (Schwarz)

Siebdruck (Farbe): Beidseitig, Weiß

Elektrischer test

OBERFLÄCHE: DIESE BOARD WIRD IMMISSIONSGOLDIERT NACH IPC-6012.

DICKE soll 0,050 µM über 3-6 µM NICKEL sein.

KUPFERPLATTENLÖCHER MINIMUM .025 AVG, .020 MIN. LÖCHER KÖNNEN NICHT ANGESCHLOSSEN WERDEN, AUSSER VIAS .500 FINISH ODER KLEINER.

Ebenenschlüssel:

=====

* .GM4: Board Outline

* .TXT: NC-Bohrakte

* .GTP: Top Paste

* .GTO: Oberer Siebdruck

* .GTS: Top Soldermask

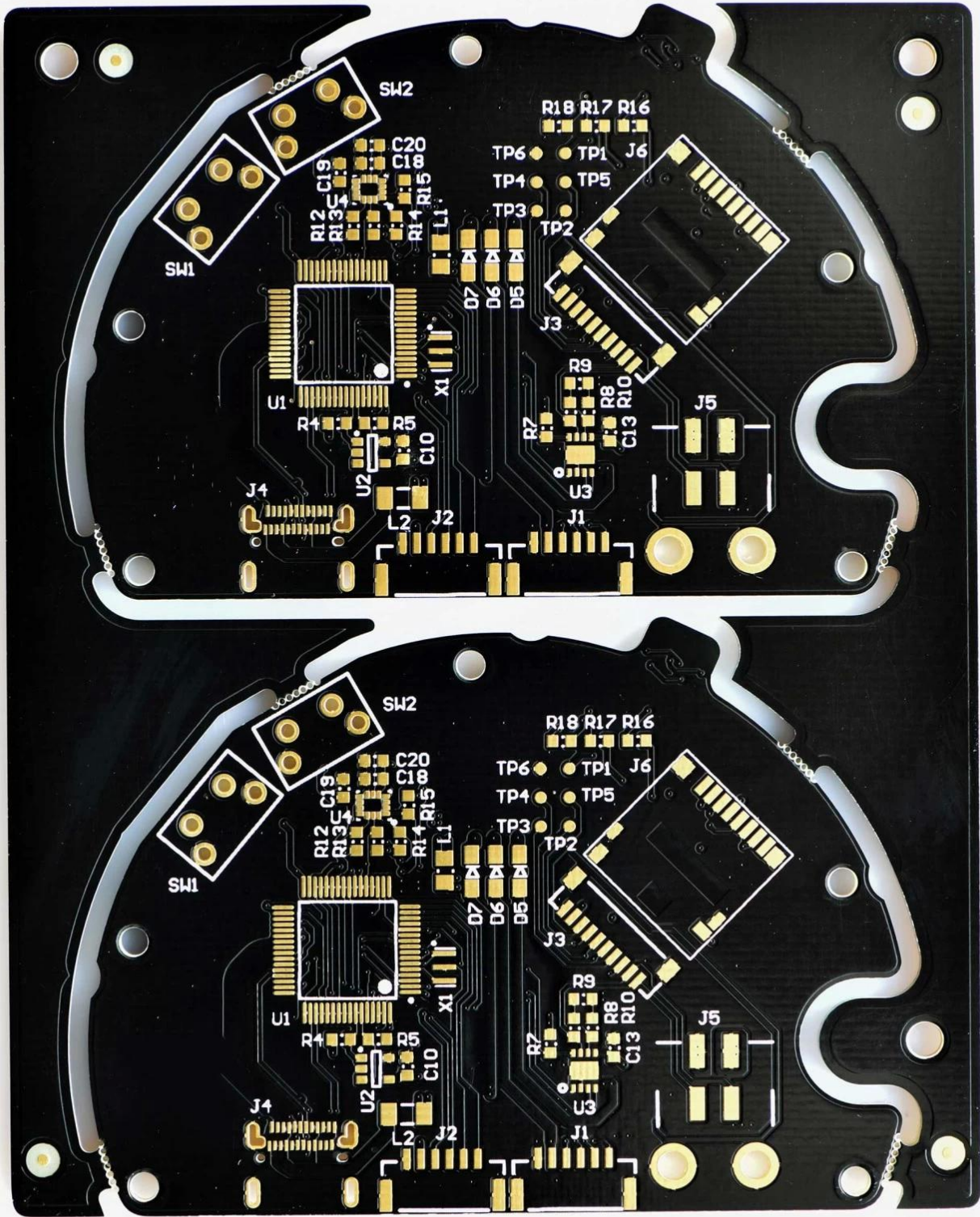
* .GTL: oberste Kupferschicht

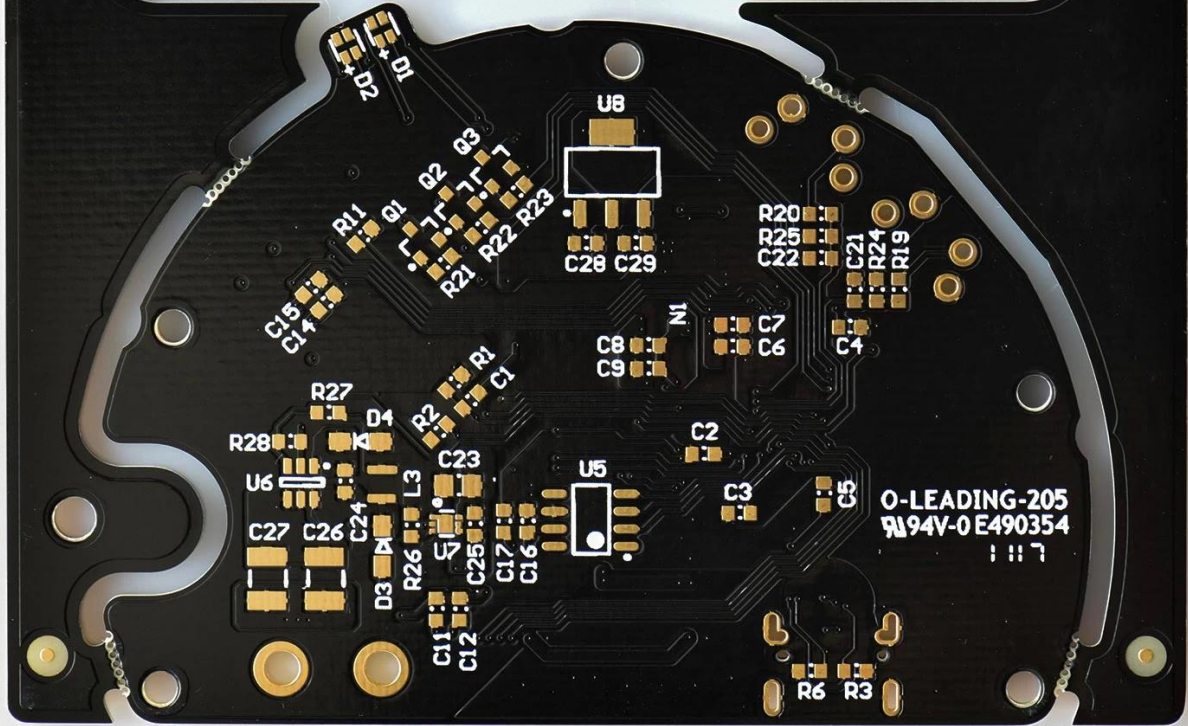
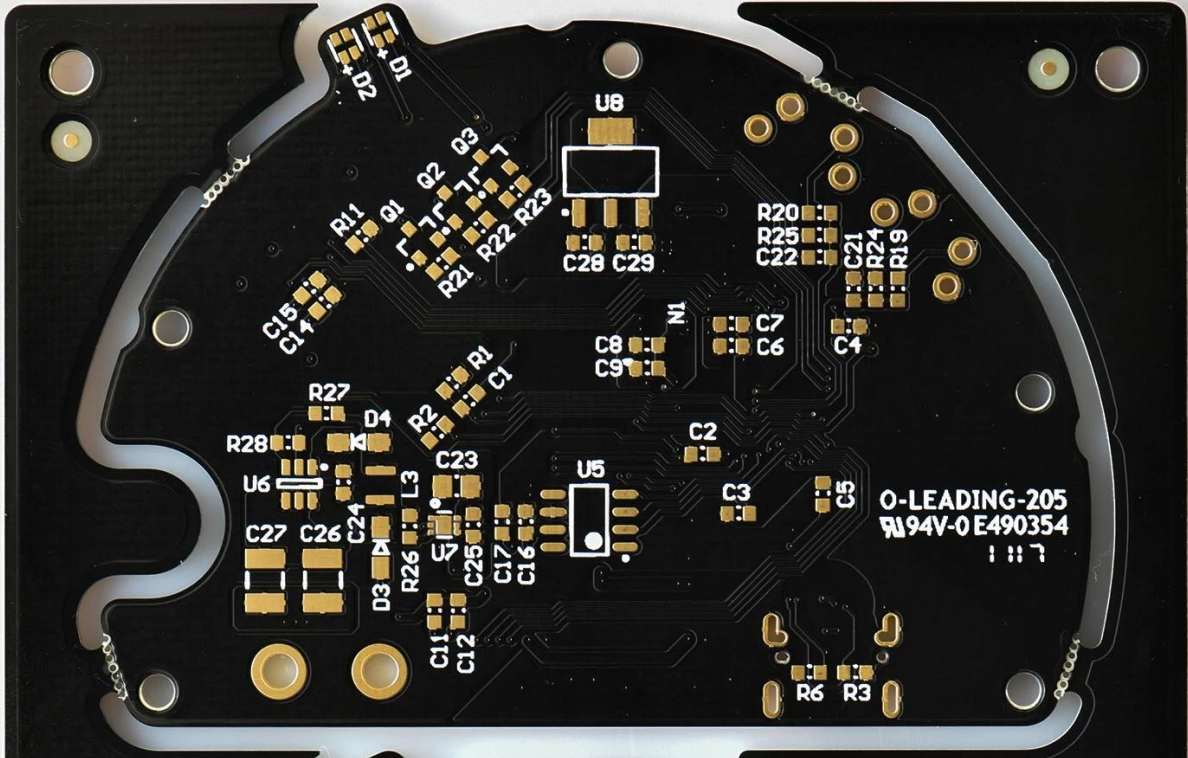
* .GBL: Untere Kupferschicht

* .GBS: Bottom Soldermask

* .GBO: Unterer Siebdruck

* .GBP: Bottom Paste





[Leiterplattenhersteller in China](#)